



全自动紫外/绿激光精密切割设备

Automatic UV / green laser precision cutting machine

针对消费类电子行业各类材料的关键零件超精细制造需求，采用自检测、自诊断、自反馈以及自主决策等加工与控制技术，实现NG不良检测及剔除，贴板后的产品可直接进入清洗和COB产线。适用于PCB、FPC、COMS摄像头等产品的高精密高效切割。

- 设备集成全自动盒装上料、上料检测、双头激光切割、切割检测、摆盘入Tray；
- 采用高性能激光器、高精度直线电机工作平台；
- 能及时发现设备异常、并采取制动措施，减少不良品产出；
- 自动定位、软件自动校正；
- 软件界面实时反馈，实时了解加工状态。

主要技术参数	产品型号 MU300A
产品上下料方式	插槽式Cassette上料 / Tray盘收料
产品规格 (mm)	150×50 ~ 300×100
MARK定位精度 (mm)	± 0.005
切割精度(中科条件) (mm)	± 0.03
激光器输出功率 (W)	15 / 25 / 35 / 60
输出波长 (nm)	355 / 532
接受文件类型	DXF
电源	AC220V / 15KW
环境温度 (°C)	室温18 ~ 25
环境湿度 (%rh)	30 ~ 75, 不结露
主机重量 (kg)	4500
主体尺寸 (mm)	3500(宽)×1700(深)×1900(高)

